

证券简称：翱捷科技

编号：2025-0704

1

	在持续发展中。在某些受限美国新规的领域，公司也做了相应的技术准备，有针对性地利用长期积累的大型 SoC 芯片及系统级设计的技术优势，通过技术创新与新型架构设计，在合规的基础上向系统厂商提供满足要求的 ASIC 芯片设计服务。 Q：公司在 ASIC 业务上的收入预期如何？ A：公司目前订单承接情况良好，由于大型 ASIC 项目固有的长周期属性，结合各项目的推进计划，预计 2026 年 ASIC 业务收入将取得大幅增长。 需特别说明的是，因预测周期距当前时点尚有一定时间跨度，政策环境、项目交付进度等客观因素可能存在动态变化，具体数据以当年审计数字为准，请投资者注意投资风险。 Q：公司 ASIC 业务的客户订单是否具有可持续性？ A：一方面公司 ASIC 定制业务选择客户的偏好是一线行业头部客户或一线大型系统厂商，深度与客户具体应用绑定开发。这些厂商往往有后续量产需求，且有继续迭代升级的需求或者新项目规划。从过去情况看，我们跟某些客户已经达成多轮次项目合作。 另外一方面，如前所述，ASIC 定制业务的市场空间在扩容。 因此，基于良好的客户基础、市场空间及公司服务能力等因素，公司对订单的可持续性保持乐观。 Q：公司上半年蜂窝物联网芯片的出货量及景气度如何？听说贵公司有缺货的情况？是上游晶圆供应受限还是封测受限？ A：今年上半年，公司蜂窝物联网芯片的市场需求旺盛，
--	---

	出货量增长较快，我们感觉下游终端景气度较高。由于市场需求增速显著超过前期产能规划，导致部分蜂窝物联网产品处于缺货状态，公司已通过增加晶圆投片量、加大封装测试投产计划等措施提升供给能力。当前公司供应链整体保持稳定，上游晶圆代工及封测环节未出现产能受限情形。后续公司将根据市场需求持续动态增强产能规划，力争尽快缓解部分产品供应紧张局面。 Q:请问公司首款四核手机芯片的最新市场进展情况？ A：公司首款四核智能手机芯片已成功实现商用，载有该芯片的平台已经在多种终端项目中进行推进，包括手机、智能手表、智能模组、智能支付终端、智能教育终端、智能POS机、PDA、DVR等。该芯片在2024年出货量超过百万颗，充分验证了其性能表现以及平台系统整体的稳定性与可靠性，标志着公司在安卓智能终端领域取得了关键性进展，为后续推出八核智能手机芯片奠定了坚实的基础。目前公司该款智能手机芯片在手订单充足，2025年全年出货量较2024年预计将实现成倍增长。 Q:请问公司首款八核手机芯片的最新市场进展情况？ A：公司首款八核智能手机芯片已于2025年上半年成功导入手机客户，该芯片聚焦性能提升、功耗优化与成本效益平衡，可以满足市场对高性价比4G智能手机解决方案的需求，同时也支持客户扩展出智能模组、车载座舱、平板电脑等多元化产品线，目前公司已经完成多项目、多客户导入，其中首发智能手机客户将于今年第三季度实现产品上市，而非手机类项目已经有终端在第二季度上市。 Q:请问公司第二款八核手机芯片的最新进展情况？
--	---

	A: 第二颗 4G 八核智能手机芯片流片, 该芯片采用 6nm 先进制程, 与目前市面上最高规格的 4G 产品比, 公司产品除了采用同样先进的工艺制程, 在产品性能特点上, 将更具差异化竞争优势, 比如该芯片支持 LPDDR5/5X, 提供 6400Mbps 以上的数据吞吐率, 并搭载高达 20TOPS 算力的独立 NPU, 可以支持目前各种主流的适用于移动终端的大模型。该芯片预计 9 月份左右回片, 年底开始导入客户, 预计明年上半年开始逐步进入客户量产阶段。 Q: 请问公司的 5G 智能手机芯片的最新进展? A: 目前, 首颗 6nm 5G 八核智能手机芯片已进入研发后期, 该款芯片具备先进的 5G-A 通信能力及高性能 AI 能力, 将进一步完善公司智能手机芯片的产品布局。预计今年下半年流片, 明年下半年开始进行客户导入工作。 Q: 目前智能手机基带市场被高通、联发科等大厂主导, 公司怎么破局? A: 公司作为智能手机基带芯片的新进入者, 尽管在市场开拓过程中可能存在一定的困难, 但是智能手机的市场容量巨大, 且随着 5G 技术普及、新兴市场需求释放, 行业仍存在结构性增长机遇。公司将采取从四核到八核、从 4G 到 5G、从白牌到新兴市场海外品牌再到一线品牌的策略逐级推进, 把每一代芯片做稳定, 每一个客户项目做扎实, 进而在获得市场认可的基础上, 争取收入规模迈上新台阶。 Q: 请问公司 RedCap 芯片的最新市场进展情况? A: 在 5G RedCap 领域, 公司首款芯片 ASR1903 已率先在物联网市场实现商用, 已获得中国移动、中国联通两大运营商的认证, 且客户进展较为顺利, 目前 1903 已经有 10+客户
--	---

	如移远，Simcom，美格，有方，中移物联，移科等共 30+模组及产品送样测试或者发布，场景包括车载，MBB，工控等领域。 面向智能穿戴市场，公司推出的 RedCap 芯片平台 ASR3901 已具备量产商用能力，该平台将为 5G RedCap 智能穿戴终端提供高效、经济且性能卓越的解决方案，助力 5G 智能穿戴市场的繁荣与多样化发展。目前已经有 15+款终端完成入网入库测试，且已经开始小规模出货。 此外，公司开发的全球首款 RedCap+Android 智能芯片平台 8603，不仅支持 5G RedCap 与 LTE Cat.4 双模，同时采用高性能 1xA76+3xA55 架构，凭借高效 GPU、自研 ISP 和 NPU，展现出出色的 AI 与多媒体性能，今年第一季度推出后受到市场广泛关注，目前处于客户 design in 阶段，预计终端产品将于今年第四季度上市。 Q：今年股权激励会有新的变化或新的激励计划吗，今年的股份支付费用会增加吗？ A：今年公司暂时未有新的股权激励计划安排。前期股权激励相关工作已按计划推进，其中 2023 年完成首次授予，2024 年完成预留授予。从股份支付费用来看，根据前两次授予的股权工具在本年度的摊销节奏测算，预计 2025 年股份支付费用对全年业绩的影响将低于 2024 年水平。这一变化主要系前期激励计划的股份支付费用在授予初期摊销比例较高，随着时间推移，后续年度的摊销金额将按既定会计政策逐步递减。
附件清单(如有)	无